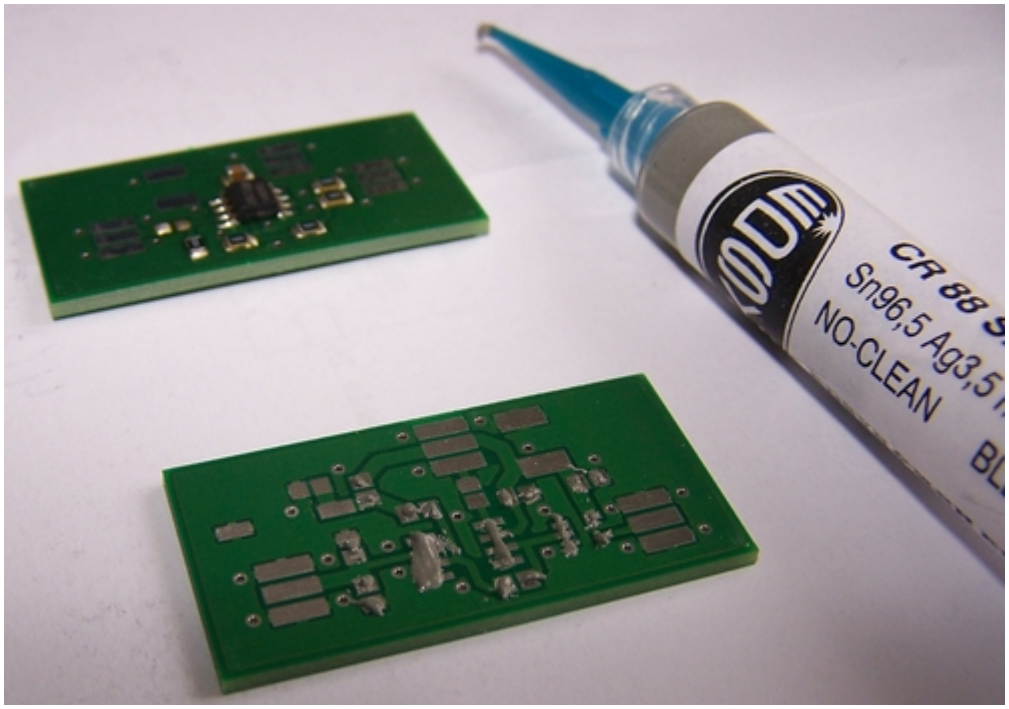
Ingredienten

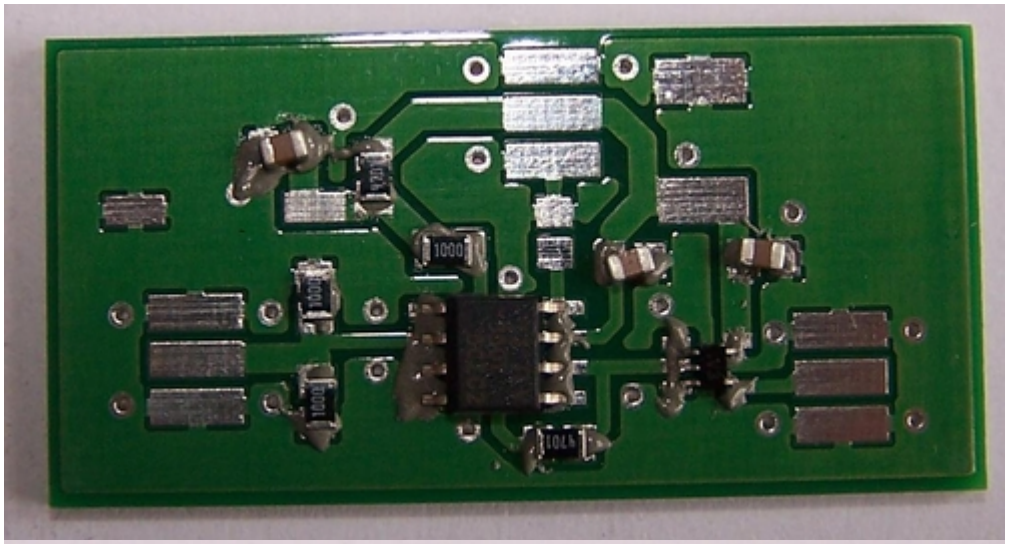
- Lötpaste (hier: Farnell 1521898 oder Reichelt CR 88, die 10 gram wirden für viele Platinen ausreichen).

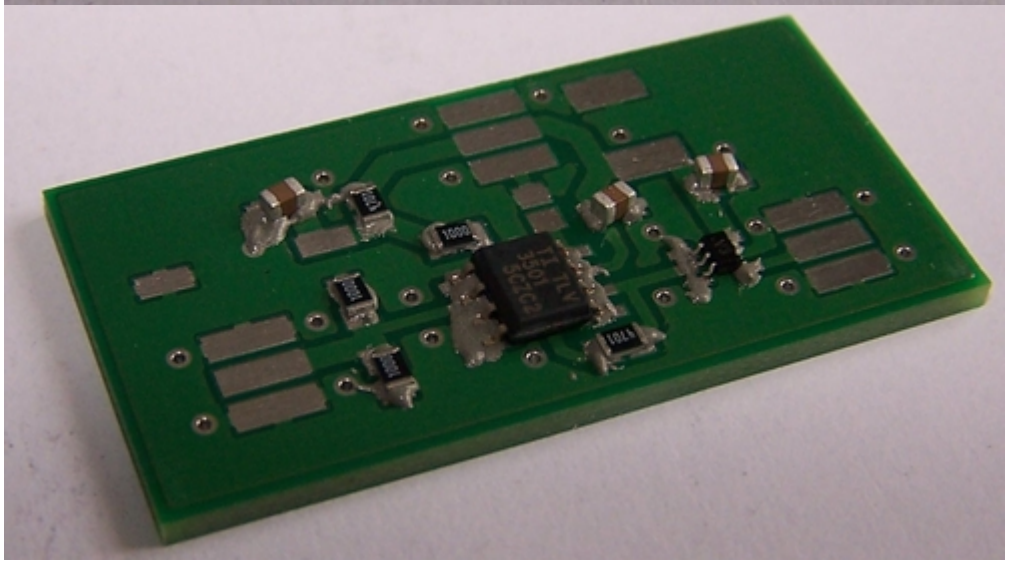
- Leiterplatte. Der Unterseite muss flach sein, also Platinen mit SMD auf nur einer Seite und befor irgendwelche bedrahte Bauteilen drauf sind.
- SMD Bauteilen wie ICs, Widerstanden oder Kondensatoren.

Vorbereitung

Lötpaste auftragen und die Bauteilen in die Paste gepressen. Die Paste muss nicht perfekt auf die einzelne Pads liegen. Eine sauerei wie im Bild gezeicht ist, ist in ordnung. Auch die Bauteilen dürfen ein bisschen schief liegen wie die drei Kondensatoren. Alle Bauteilen sollen zugleich platziert wirden, damit die Teilen nur einmal erhitzt werden müssen.

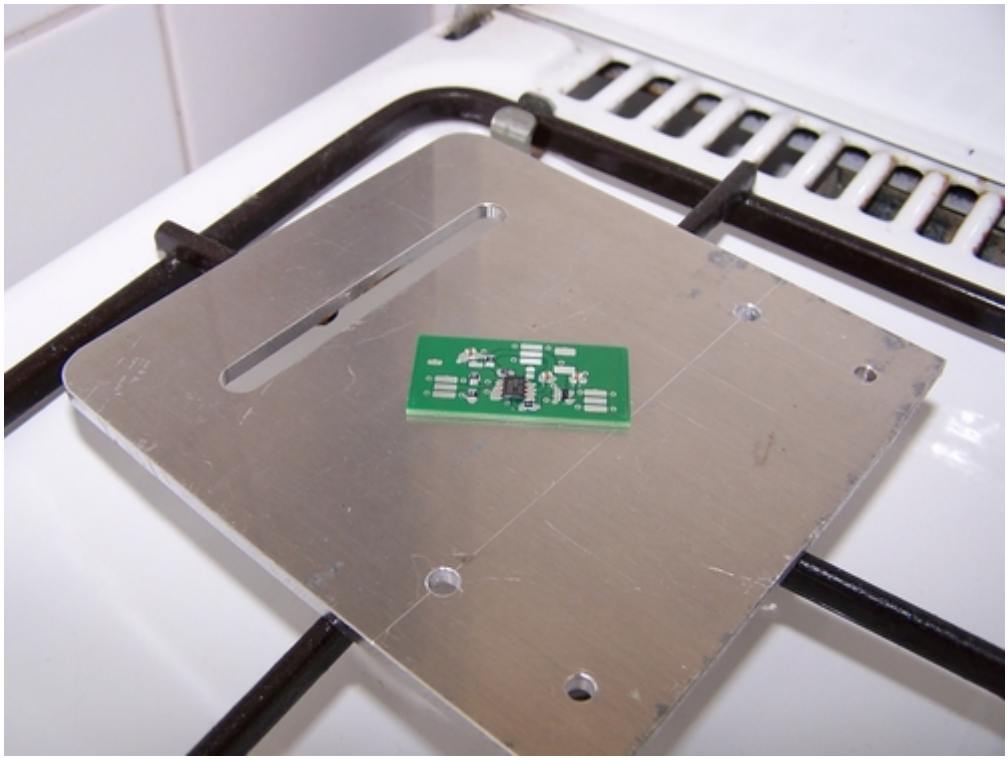


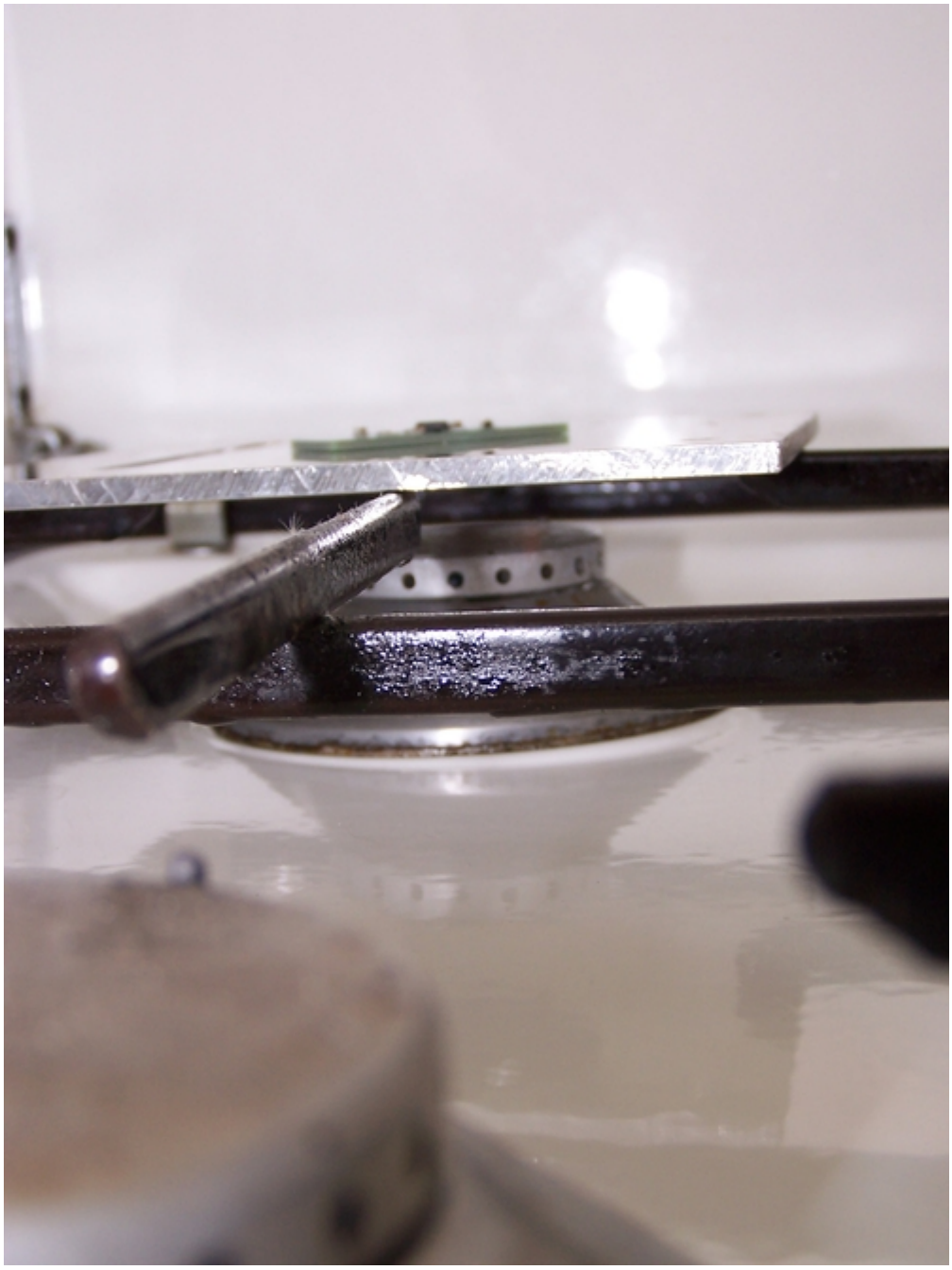




Backen

Auf dem Herd. Die Alu Platte ist nur 4 mm dick und ist dafür um die Wärme gleichmäßig zu verteilen. Die Leiterplatte mittig auf die Platte legen, und den Herd anmachen. Nach etwa anderhalb minuten ändert sich die Farbe etwas, dunkelgrau zu leichtgrau, und danach wird den Lötzinn selbst flüssig und zieht sich und die Bauteilen auf den Pads. Nach etwa zwei oder drei minuten ab gas anmachen, ist es zu ende. (Noch länger und es fangt an zu rauchen.)

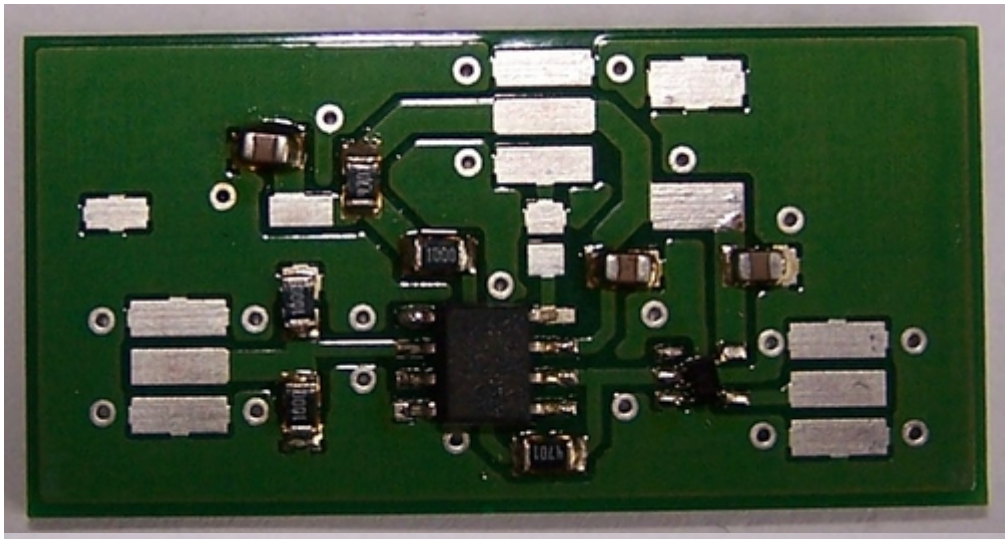


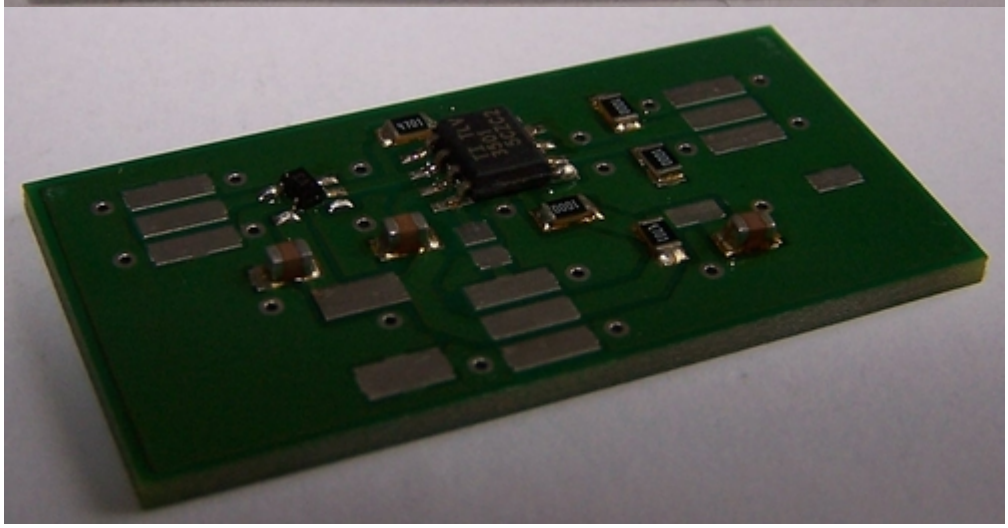


(Entschüldigung, wenn meine Herd nicht perfekt sauber war.)

Das Ergebnis

Alle Lötpunkten sind angeschlossen. Einige lötpunkten sind sehen zwar zweifelhaft aus, sind aber verbunden; die Lötpaste hätte ich vielleicht doch ein bisschen gleichmäßiger verteilen sollen. Die schräge Kondensatoren sind fast gerade gerückt. Nur ein IC war nicht gelungen weil die Lötpads nicht zu den Device passen.





Ausblick

Diese erste Erfolge mit Lötpaste eröffnen den weg zur benutzung von 'Bein freie' Gehäuse wie QFN, LFCSP oder BGA.

–Thijs

From:
https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/ - **ElektronIQ**

Permanent link:
https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=fertigung:selbstloetenmitloetpaste&rev=1214393490

Last update: **2008/06/25 11:31**